

小型 S I P パッケージ・シリーズ・ハイブリッド I C

特 長

- シングルイン・ライン構造であるため、基板実装面積を小さくすることができます。
- 入出力や電源ピンの配列は、標準化されています。
- 表面実装部品 (S M D) の使用により、自動組立が可能になり、小型・低価格化を実現できました。
- 個別部品を使用し、電気的特性を重視した設計が可能となりました。
- 本シリーズのHICは、簡単に扱えるよう、外付け部品を極力減らす設計となっています。
- 電源回路には、バイパスコンデンサ ($0.1\mu\text{F}$ セラミック) を実装しているため、ボード上でのバイパスコンデンサは不要です。

使用上の注意

- シングルイン・ライン構造のため、ICソケットの使用はしないでください。
- 高さ制限のため、斜めあるいは水平に実装する場合は、ピンの長さにも余裕をもって折り曲げてください。(何度も折り曲げると折れ易いため)
- 電源端子は端から、 $+V_{CC}$ 、 $-V_{CC}$ 、 $0V$ の順番です。電源端子には、逆接続に対処するため、保護ダイオードを内蔵していますが、 \pm 逆接続をし続けると、保護ダイオードが破損しますので注意してください。

外形寸法について

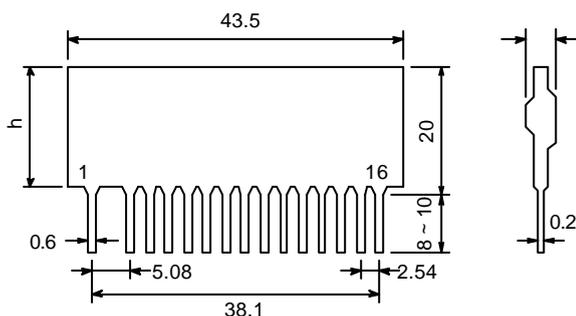
- SIPパッケージ・シリーズ・ハイブリッドICの外形寸法は、図のように 2.54mm ($1/10$ インチ) ピッチのシングルイン・ライン構造で、製品によってピン数と、高さ (h) が異なります。
規格中で、 $SIP-x \times PIN \ h = x \times \text{mm}$ で表示し、高さ h は本HICをプリント基板に実装したときの、部品面からの高さを表示してあります。
横幅については若干のばらつきがありますが、約 (ピン数+1) $\times 2.54\text{mm}$ でSIP-16PINでは、約 43mm 、24PINで約 64mm です。
- 2番ピンは、誤挿入を防止するため、あきピンにしてあります。
- 基板設計 (アートワーク) をする際は、HICを容易に抜き取れるよう、孔あけ寸法をできる限り大きく (0.8mm 程度) してください。

特注品について

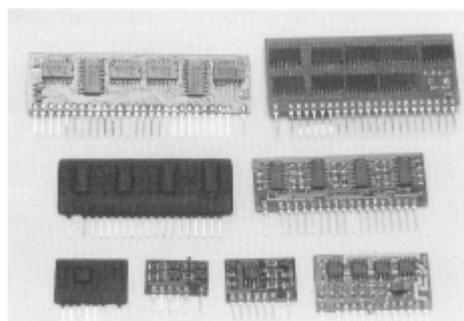
本カタログに記載されている製品の他に、多くのハイブリッドICを生産しています。カスタム製品を御希望される場合は下記の要領でお問い合わせ頂ければ、御見積いたします。

- 電気的な仕様または回路図 (弊社で回路設計も可能)。
(弊社にて回路設計から行う場合は、試作後に貴社の御承認が必要)。
- 希望外形寸法 (ピン数と高さ制限)。
- 片面あるいは両面実装のいずれかを指定。
- ロット当りの製作個数 (予定) と希望価格。
- 見積項目は次の通りです。

回路設計・試作費・プリント基板設計費・基板フィルム作成費・材料費・組立費・検査費 (必要に応じて検査治具製作費)
エポキシモールド及び社名及び形式印刷費



< S I P - 1 6 P I N の外形寸法例 >



< 製品の例 >